

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

**上海韦尔半导体股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计分配现金红利总额为 60,450,361.86 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 12.98%。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾渊	任冰
办公地址	上海市浦东新区上科路88号	上海市浦东新区上科路88号
电话	021-50805043	021-50805043
电子信箱	stock@sh-willsemi.com	stock@sh-willsemi.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他

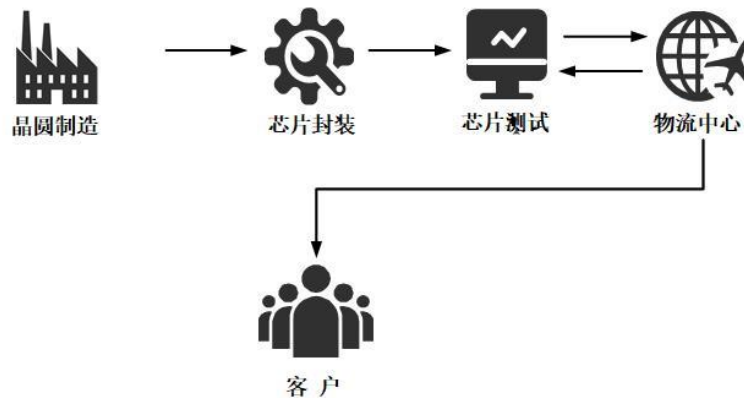
电子设备制造业（C39）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

考虑到公司半导体设计业务及半导体分销业务并存的特性，根据行业及公司现状，公司在经营模式上有效整合了半导体设计和分销业务。公司设计业务依托公司分销业务的渠道优势，利用分销体系分析的客户需求信息，有针对性的提供满足客户需求的产品，并为公司产品研发方向提供市场信息作为参考。同时，公司分销业务凭借设计业务积累的技术优势，能为下游客户提供更好的解决方案，保证公司在分销业务市场的竞争优势。

## 1、半导体设计业务

### （1）公司采用 Fabless 的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的 Fabless 模式，公司仅从事集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商，公司从晶圆代工厂采购晶圆，委托集成电路封装测试企业进行封装测试。



公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜，以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购，公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司，市场知名度高，与公司有着长期稳定的合作关系，产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内，公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司，经营稳定，市场知名度较高，能够按照产能和周期安排订单生产，报价基于市场化原则，公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广，根据行业、产品及市场需求情况，公司相应选择直销和代销

的方式进行销售。总体而言，公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM 厂商、OEM 厂商及终端客户，直销模式可以保障公司服务效率，根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外，公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式，公司可有效降低新客户开发的成本，在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时，也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

## (2) 公司设计业务产品类型

公司研发设计的半导体产品主要包括图像传感器产品和其他半导体器件产品两大产品类型，具体产品包括以下部分：

产品名称	主要功能	应用领域	技术优势
CMOS 图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号，是数字摄像头的重要组成部分	消费类电子、安防、汽车、医疗、AR/VR 等	8 万像素到 6400 万像素领域全面覆盖；可实现摄像头更高速的自动对焦；降低功耗并保障了图像质量；显著提升在无光和低光环境下的图像捕捉能力；能捕捉高速移动物体，且不会产生空间失真；可根据不同设备的尺寸大小、光敏度、封装类型以及芯片内嵌式图像信号处理等方面的区别，提供特色化的产品解决方案
微型影像模组封装（Camera Cube Chip）	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和 CMOS 图像传感器创新的解决方案，可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、手机、物联网、AR/VR 眼球追踪等	目前医疗内窥镜领域技术最先进的摄像头之一；提供业界最小的相机模组解决方案；使用半导体工艺制造镜头；可过回流焊，无需底座或人工插接模组
硅基液晶投影显示（LCOS）	反射模式，尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车和医疗机械等	LCOS 将控制电路放置于显示装置的后面，可以提高透光率，从而达到更大的光输出和更高的分辨率。为微型投影系统提供了一个高解析度（HD）、外形紧凑、低功耗和低成本的微型显示器解决方案

特定用途集成电路产品 (ASIC)	支持公司 CMOS 图像传感器, 在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用, 提供 USB、并行、串行接口解决方案以及压缩引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车等	支持高动态范围、多路环视影像处理, 同时支持鱼眼矫正、画中画、图像叠加等高级图像功能的实现, 提供完美的汽车影像解决方案; 可进行多路摄像头的拓展, 并且支持多幅图像的拼接处理
TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	采用先进的沟槽技术和超薄化封装技术, 可提供最小封装尺寸达 0.6mm*0.3mm 规格封装的产品, 并已进入国内第一批电容小于 0.4PF 产品的量产阶段, 其 ESD 性能具备国际领先水平
MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	拥有多层外延技术、背面减薄技术和芯片倒装技术等多项核心技术, 目前最小 pitch (特征尺寸) 小于 1 $\mu$ m, 最小设计线宽小于 0.2 $\mu$ m
肖特基二极管	电源整流, 电流控向, 截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	采用先进的沟槽技术, 产品具有优异性能指标及电学参数
LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富, 并形成专利技术
DC-DC	起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富, 并形成专利技术
LED 背光驱动	构造一个恒流源电路, 确保任何条件下背光 LED 的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富, 并形成专利技术
模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等	在模拟电路的整体架构及设计模块方面积累丰富, 并形成专利技术
直播芯片	对高清数字信号解码、输出等	机顶盒	拥有丰富的 SoC 芯片设计经验和先进工艺设计的物理实现经验积累
射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信	提供国内首创多模/多频功放新架构射频芯片, 并开发了 TD-LTE 射频功放技术
MEMS 麦克风	实现声信号转换为电信号	消费类电子如智能音箱、无线耳机等	应用特有的封装结构提高声学性能, 尺寸小, 高信噪比, 功耗低

## 2、半导体产品分销业务

### (1) 半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商,与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的 FAE 队伍,顺应国内半导体行业的产业地域布局,公司分销体系境内外多地设立了子公司,构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式,具体分为境内采购和境外采购两部分:①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行;②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析,公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本,以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广,同时也能更好的了解客户的需求,进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求,代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

### (2) 半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件(包括电阻、电容、电感、晶体、接插件、连接器等)、结构器件、分立器件、IC、显示屏模组等。

产品名称	细分产品	主要代理原厂	应用领域
被动件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、AVX、LIZ、WALSIN、HEC 等	移动通信、家用电器、安防电子、数码产品、智能穿戴、金融支付、工业设备、电力设备、电机控制、电源、仪器仪表、汽车及部件、消防、照明、轨道交通等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB 等	Molex、松下、南亚等	
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、VISHAY 等	
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash 等	光宝、江波龙、XMC、Zetta、ISSI 等	
射频器件	滤波器等	松下、ACX 等	
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT 等	智晶、LGD 等	车载市场

公司会根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素,对所代理的产品线进行动态管理。在开发新产品线的同时,对某些竞争力较弱、可替代性较高等不符合公司分销业务发展战略的产品公司进行过滤,将逐步降低代理数量或不再代理。由于终端设备市场产品更新换代速度较快,公司需同下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系,在及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求的基础上,有针对性的进行技术研发和储备,使企业的新技术能顺应市场变化,减少下游行业变化带来的负面影响。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年 增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	17,476,223,432.68	15,589,356,096.62	4,599,872,273.92	12.10	2,824,908,203.63
营业收入	13,631,670,629.57	9,701,902,368.56	3,963,509,424.61	40.51	2,405,916,266.81
归属于上市公司股东的净利润	465,632,238.67	144,991,902.55	138,804,364.26	221.14	137,156,318.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,201,677.11	132,553,764.37	132,553,764.37	152.13	120,567,028.45
归属于上市公司股东的净资产	7,926,394,295.30	3,983,942,540.00	1,635,555,967.17	98.96	1,179,764,415.88
经营活动产生的现金流量净额	805,335,234.79	790,006,614.66	5,401,858.32	1.94	-271,954,275.88
基本每股收益（元/股）	0.76	0.29	0.32	162.07	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.30	0.33	143.33	0.34
加权平均净资产收益率（%）	10.17	4.94	10.08	增加 5.23个 百分点	13.39

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,646,467,818.64	3,056,953,676.46	3,702,551,908.30	4,225,697,226.17
归属于上市公司股东的净利润	49,454,973.86	26,346,407.09	59,325,080.47	330,505,777.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,735,317.91	-11,487,192.89	46,446,207.80	272,507,344.29
经营活动产生的现金流量净额	-409,155,417.77	455,312,166.10	-290,751,169.24	1,049,929,655.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

2019年8月28日，公司已完成北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）42.27%股权、北京视信源科技发展有

限公司（以下简称“视信源”）79.93%股权登记手续，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续。本次收购完成后，北京豪威成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。公司与北京豪威在合并前后均受控股股东虞仁荣先生控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，追溯调整前期财务报表数据。

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与第四季度差异较大主要是因为：同一控制下企业合并会计处理造成，2019年9月至2019年12月北京豪威实现的利润全部归属于上市公司股东净利润。

公司各季度经营活动产生的现金流量净额差异较大主要是因为：公司营业收入增加，销售商品收到现金相应增加；公司第三、四季度营业收入增长较多，2019年9月当月营业收入大幅增长，销售收到的现金在第四季度实现。

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

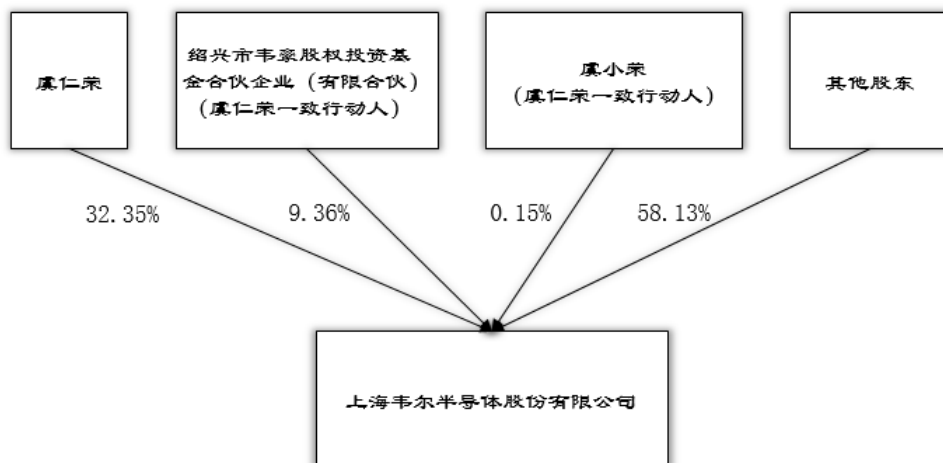
截止报告期末普通股股东总数（户）					23,265		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,076		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前10名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
虞仁荣		279,435,000	32.35	279,435,000	质押	151,010,205	境内自然 人
绍兴市韦豪股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	80,839,009	80,839,009	9.36	80,839,009	质押	80,839,009	境内非 国有法 人
青岛融通民和投资中心 （有限合伙）	62,187,073	62,187,073	7.20	62,187,073	无		境内非 国有法 人
Seagull Strategic Investments (A3), LLC	30,980,219	30,980,219	3.59	30,980,219	无		境外法 人
嘉兴水木豪威股权投资合	26,814,084	26,814,084	3.10	26,814,084	无		境内非



伙企业（有限合伙）							国有法人
嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）	26,814,084	26,814,084	3.10	26,814,084	无		境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）	22,997,032	22,997,032	2.66	22,997,032	无		境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	22,901,063	22,901,063	2.65	22,901,063	无		境外法人
香港中央结算有限公司	22,263,903	22,263,903	2.58		无		境外法人
深圳金石中睿投资管理有限公司—开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,330,959	20,330,959	2.35	20,330,959	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）为虞仁荣先生控制的企业，虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，均为虞仁荣先生一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

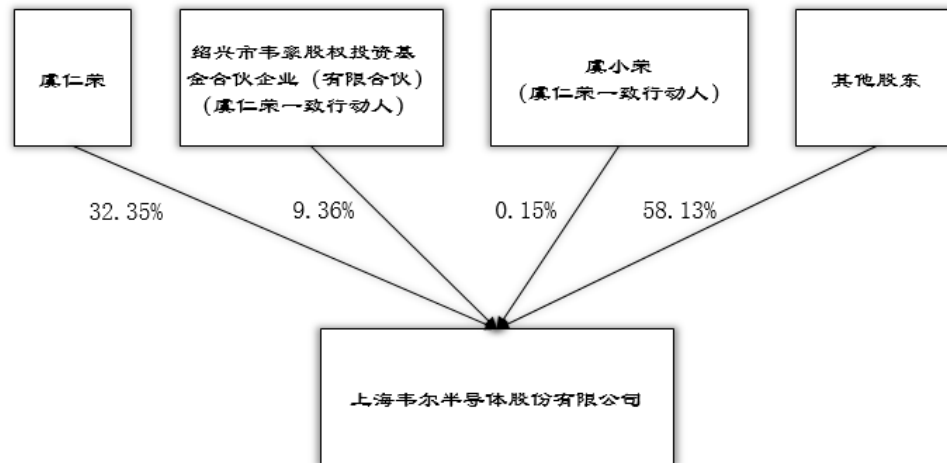
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业总收入 136.32 亿元，较 2018 年追溯调整后营业总收入增长 40.51%；公司归属于母公司股东的净利润为 4.66 亿元，较 2018 年追溯调整后归属于母公司股东的净利润增加 221.14%。

### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>	<p>第五届董事会第二次会议、第五届董事会第七次会议</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 95,776,206.89 元，“应收账款”上年年末余额 1,483,043,120.74 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 100,000,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,295,432,887.27 元。</p>	<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 23,460,740.23 元，“应收账款”上年年末余额 284,461,508.66 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 11,759,405.19 元。</p>
<p>(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。</p>	<p>第五届董事会第二次会议、第五届董事会第七次会议</p>	<p>无影响</p>	<p>无影响</p>

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	第四届董事会第三十八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 12,569,951.68 元。交易性金融资产：增加 12,569,951.68 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 9,320,000.00 元。交易性金融资产：增加 9,320,000.00 元。
(2) 将部分“应收款项”重分类至“应收款项融资”	第四届董事会第三十八次会议	应收票据：减少 95,776,206.89 元 应收款项融资：增加 95,776,206.89 元	应收票据：减少 23,460,740.23 元 应收款项融资：增加 23,460,740.23 元
(3) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产：减少 29,370,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 21,360,000.00 元 留存收益：减少 7,209,000.00 元 递延所得税资产：增加 801,000.00 元	可供出售金融资产：减少 29,370,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 21,360,000.00 元 留存收益：减少 7,209,000.00 元 递延所得税资产：增加 801,000.00 元
(4) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第四届董事会第三十八次会议	可供出售金融资产：减少 56,160,602.36 元 其他权益工具投资：增加 49,974,598.67 元 其他综合收益：减少 6,186,003.69 元	无影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
上海韦矽微电子有限公司
韦尔半导体香港有限公司
合肥韦豪半导体技术有限公司
北京泰合志恒科技有限公司
武汉泰合志恒科技有限公司
上海矽久微电子有限公司
无锡中普微电子有限公司
安浦利科技有限公司
上海韦玗微电子有限公司
无锡韦尔半导体有限公司
上海磐巨电子科技有限公司
武汉耐普登科技有限公司
武汉韦尔半导体有限公司
武汉韦尔投资管理有限公司
上海韦孜美电子科技有限公司
上海夷易半导体有限公司
绍兴韦豪半导体科技有限公司
深圳市芯能投资有限公司
深圳市芯力投资有限公司
绍兴豪威半导体有限公司
香港华清电子（集团）有限公司
香港鸿光兴盛电子有限公司
北京京鸿志科技有限公司
深圳市京鸿志电子有限公司
苏州京鸿志电子有限公司
深圳市京鸿志物流有限公司
鸿光电子元件（深圳）有限公司
上海灵心电子科技有限公司
香港灵心电子科技有限公司

深圳东益电子有限公司
香港东意电子有限公司
上海树固电子科技有限公司
香港树伟朋电子科技有限公司
北京豪威科技有限公司
Seagull Investment Holding Limited
Seagull International Limited
OmniVision Technologies, Inc.
OmniVision International Holding Limited
OmniVision Technology International Ltd.
OmniVision Technologies (HongKong) Company Limited
OmniVision Trading (HongKong) Company Ltd.
OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited
豪威半导体(上海)有限责任公司
豪威科技(上海)有限公司
台湾豪威科技有限公司
台湾豪威国际科技有限公司
OmniVision Holding (HongKong) Company Limited
OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.
北京豪威亦庄科技有限公司
上海全览半导体技术有限公司
OmniVision Optoelectronics Company Limited
豪威光电子科技(上海)有限公司
台湾豪威光电科技股份有限公司
OmniVision Semiconductor Technologies Marketing India Private Limited
OmniVision Technologies Norway AS
OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd
豪威科技（武汉）有限公司
OmniVision Technologies Japan G.K.
OmniVision CDM Optics, Inc.
北京视信源科技发展有限公司
北京思比科微电子技术股份有限公司
思比科（香港）有限公司
太仓思比科微电子技术有限公司
天津安泰微电子技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2019 年年度报告“第十一节 财务报告/八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益”。